EVATHENE® 超塑烯®

ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER RESINS
乙烯醋酸乙烯酯共聚合树脂

产品 Products / 物性 Physical Properties	单位 UNIT	检验方法 TEST METHOD (ASTM)	发泡 Foaming			
			UE629	UE630	UE632	UE659
主要用途 MAIN APPLICATIONS			• 鞋材发泡 • 食品包装 • Shoe sole foaming • Food packaging	• 鞋材发泡 • 食品包装 • Shoe sole foaming • Food packaging	• 鞋材发泡 • 替代软质PVC、橡胶与其他弹性材料 • Shoe sole foaming • Replace the flexible PVC, rubbers and other elastomers	• 鞋材发泡 • 配制热熔胶 • 电线电缆掺合树酯 • Shoe sole foaming • Hot melt adhesives • Wire & Cable Compounds
VA 含量 VA CONTENT	百分率 %	USI	18	16	22	25
熔值 MELT INDEX	克/10分 g/10min	D1238	2.5	1.5	2.2	2.0
密度 DENSITY	克/立方公分 g/cm³	D792	0.939	0.937	0.942	0.947
断裂点抗张强度 BREAK POINT TENSILE STRENGTH 模片(MOLDED)	公斤/平方公分 kg/cm²	D638	180	170	170	210
伸长率 ELONGATION 模片(MOLDED)	百分率 %	D638	750	700	820	890
低温脆裂温度 LOW TEMPERATURE BRITTLENESS	度/半数破坏 ℃/F50*	D746	＜-76	＜-76	＜-76	＜-76
卫氏软化温度 VICAT SOFTENING TEMPERATURE	度 ℃	D1525	64	67	58	54
环球软化温度 RING & BALL SOFTENING TEMP.	度 ℃	E28	—	—	—	—
熔点 MELTING POINT	度 ℃	D3418	86	89	82	77
硬度 HARDNESS Shore A	萧氏A Shore A	D2240	90	91	86	84

产品 Products / 物性 Physical Properties	发泡 Foaming						油墨 Ink
	UE33002	UE3302	UE3312	UE3330	UE4003	UE4055	UE40K
主要用途 MAIN APPLICATIONS	• 鞋材发泡 • 电线电缆掺合树酯 • Shoe sole foaming • Wire & Cable Compounds	• 鞋材发泡 • 一般掺合应用 • Shoe sole foaming • General Compounding	• 鞋材发泡 • 电线电缆掺合树酯 • Shoe sole foaming • Wire & Cable Compounds	• 鞋材发泡 • 太阳能电池封装膜 • 一般掺合应用 • Shoe sole foaming • Solar Cell Encapsulation • General Compounding	• 鞋材发泡 • 一般掺合应用 • Shoe sole foaming • General Compounding	• 鞋材发泡 • 热熔胶 • Shoe sole foaming • Hot melt adhesives	• 配制油墨 • 热熔胶 • Binders used in ink • Hot melt adhesives
VA 含量 VA CONTENT	33	33	33	33	40	40	41
熔值 MELT INDEX	0.2	2	12	30	3	55	65
密度 DENSITY	0.956	0.956	0.958	0.956	0.967	0.966	0.968
断裂点抗张强度 BREAK POINT TENSILE STRENGTH 模片(MOLDED)	110	100	90	70	80	40	38
伸长率 ELONGATION 模片(MOLDED)	710	1000	1000	900	＞1000	＞1000	＞1000
低温脆裂温度 LOW TEMPERATURE BRITTLENESS	—	—	＜-76	—	—	—	—
卫氏软化温度 VICAT SOFTENING TEMPERATURE	—	—	—	—	—	—	—
环球软化温度 RING & BALL SOFTENING TEMP.	—	—	—	113	—	105	103
熔点 MELTING POINT	64	64	64	64	48	48	45
硬度 HARDNESS Shore A	70	65	65	63	43	40	38

F50*：50%破裂或脆裂

据本公司所知，上述数据应属正确无误，惟因使用时之情况非受本公司管制，所以本公司对上述所作之一切建议，恕不负保证之责。使用上述或其它来源之数据，所发生之一切责任，概与本公司无涉，所有风险，应由使用者自行承担。再者，本数据所述事项，绝不能解释为诱导或建议使用与现在或未来的专利权有抵触之任何加工方法或产品。

公元二〇二〇年六月发行

F50* : 50% failure

To our best knowledge, the information contained herein is true and accurate. However, since conditions of use are beyond our control, all recommendations or suggests are presented without guarantee or responsibility on our part. We disclaim all liability in connection with the use of information contained herein or otherwise. All risks of such use are assumed by the user. Furthermore, nothing contained herein shall be constructed as an inducement or recommendation to be used in any process or any product in conflict with existing or future patents.

Issued in June, 2020

EVATHENE® 超塑烯®

ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER RESINS
乙烯醋酸乙烯酯共聚合树脂

产品 Products / 物性 Physical Properties	单位 UNIT	检验方法 TEST METHOD (ASTM)	注塑/热熔胶 Injection Molding / Hot Melt									涂胶 Coating	太阳能电池封装膜 Solar Cell Encapsulation
			UE633	UE612-04	UE649-04	UE634-04	UE638-04	UE639-04	UE653-04	UE647-04	UE654-04	UE508	UE2828
主要用途 MAIN APPLICATIONS			• 配制热熔胶 • 挤压涂覆 • Hot melt adhesives • Extrusion coating	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • 鞋材发泡 • 电线电缆掺合树酯 • Hot melt adhesives • Shoe sole foaming • Wire & Cable Compounds	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • Hot melt adhesives	• 配制热熔胶 • 电线电缆掺合树酯 • 一般掺合应用 • Hot melt adhesives • Wire & Cable Compounds • General Compounding	• 粉末压烫贴合(使用于不织布热熔胶) • Powder Hot Melt (for hot melt adhesion of non-woven-fabric)	• 太阳能电池封装膜 • Solar Cell Encapsulation
VA含量 VA CONTENT	百分率 %	USI	19	19	19	28	28	28	28	28	33	8	28
熔值 MELT INDEX	克/10分 g/10min	D1238	20	150	400	6	18	150	400	800	30	85	25
密度 DENSITY	克/立方公分 g/cm³	D792	0.938	0.937	0.934	0.948	0.948	0.945	0.942	0.940	0.956	0.925	0.948
断裂点抗张强度 BREAK POINT TENSILE STRENGTH 模片(MOLDED)	公斤/平方公分 kg/cm²	D638	130	55	30	180	125	40	30	—	70	80	—
伸长率 ELONGATION 模片(MOLDED)	百分率 %	D638	790	630	300	830	900	800	500	—	900	400	—
低温脆裂温度 LOW TEMPERATURE BRITTLENESS	度/半数破坏 ℃/F50*	D746	＜-76	＜-40	＜-30	＜-76	＜-76	＜-30	＜-30	—	—	＜-76	—
卫氏软化温度 VICAT SOFTENING TEMPERATURE	度 ℃	D1525	60	47	39	45	42	40	37	—	—	70	—
环球软化温度 RING & BALL SOFTENING TEMP.	度 ℃	E28	—	98	91	145	125	89	80	80	113	—	—
熔点 MELTING POINT	度 ℃	D3418	83	82	78	73	72	67	65	63	64	96	72
硬度 HARDNESS Shore A	萧氏A Shore A	D2240	88	86	81	78	75	67	63	54	63	94	74

F50*：50%破裂或脆裂

F50* : 50% failure

据本公司所知，上述数据应属正确无误，惟因使用时之情况非受本公司管制，所以本公司对上述所作之一切建议，恕不负保证之责。使用上述或其它来源之数据，所发生之一切责任，概与本公司无涉，所有风险，应由使用者自行承担。再者，本数据所述事项，绝不能解释为诱导或建议使用与现在或未来的专利权有抵触之任何加工方法或产品。

To our best knowledge, the information contained herein is true and accurate. However, since conditions of use are beyond our control, all recommendations or suggests are presented without guarantee or responsibility on our part. We disclaim all liability in connection with the use of information contained herein or otherwise. All risks of such use are assumed by the user. Furthermore, nothing contained herein shall be constructed as an inducement or recommendation to be used in any process or any product in conflict with existing or future patents.

公元二〇二〇年六月发行

Issued in June, 2020